

進化し続けるニーズに対応する

SiC & サファイア

受託加工

**特徴1**

グラインド研削で加工時間、コストを低減

**特徴2**

高速・超平滑を得るCMP

**特徴3**

RCA洗浄による高品質実現

**特徴4**

エピ再生加工

Booth No.

〈4109〉

出展者セミナー

12月16日 14:50

場所 東4ホール

六甲電子株式会社

TEL:0798-65-4508 FAX:0798-67-5039

<http://www.rokkodenshi.com>

Mail:[info@rokkodenshi.com](mailto:info@rokkodenshi.com)